



Title of Change:	Change from 6inch to 8inch wafers for HD+B technology at Roznov wafer fab.
Proposed Changed Material First Ship Date:	09 Oct 2021 or earlier if approved by customer
Current Material Last Order Date:	07 Jul 2021 <i>Orders received after the Current Material Last Order Date expiration are to be considered as orders for new changed material as described in this PCN. Orders for current (unchanged) material after this date will be per mutual agreement and current material inventory availability.</i>
Current Material Last Delivery Date:	08 Oct 2021 <i>The Current Material Last Delivery Date may be subject to change based on build and depletion of the current (unchanged) material inventory</i>
Product Category:	Active components – Integrated circuits
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Aaron.Zierenberg@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office to place sample order or <PCN.samples@onsemi.com> . Sample requests are to be submitted no later than 45 days after publication of this change notification. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Sample Availability Date:	07 Oct 2020
PPAP Availability Date:	05 Nov 2020
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Youngchul.Lee@onsemi.com
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 12 months prior to implementation of the change or earlier upon customer approval. ON Semiconductor will consider this proposed change and it's conditions acceptable, unless an inquiry is made in writing within 45 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com .
Change Category	
Category	Type of Change
Process - Wafer Production	New wafer diameter
Process - Assembly	Change of product marking

Description and Purpose:

Move from 6inch to 8inch wafer size. Purpose to improve manufacturing capacity.

	From	To
Product marking change	8405AG	8405CG
	8405BG	8405DG
	8406AG	8406CG
	8406BG	8406DG



Reason / Motivation for Change:	Capacity improvement		
Anticipated impact on fit, form, function, reliability, product safety or manufacturability:	The device has been qualified and validated based on the same Product Specification. The device has successfully passed the qualification tests. Potential impacts can be identified, but due to testing performed by ON Semiconductor in relation to the PCN, associated risks are verified and excluded. No anticipated impacts.		
Sites Affected:			
ON Semiconductor Sites		External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Roznov, Czech Republic		None	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia			
ON Semiconductor Vietnam			
Marking of Parts/ Traceability of Change:	New OPN's with updated marking.		
Reliability Data Summary:			
QV DEVICE NAME : NCV8406BDTRKG RMS: OSV (RRF#61238, 69600) and SBN (RRF#61239) PACKAGE: 1186 (DPAK3)			
Test	Specification	Condition	Results
HTRB	MILSTD750-1, method M1038A	Tj=150C, Bias=54V, 1008 hrs	0/300
ELFR	JESD22-A108	Ta=150C, Bias=10V, 24 hrs	0/2400
TC	JESD22-A104	Ta= -__55__°C to +__150__°C	0/240
HAST	JESD22-A110	Ta=130C, RH=85%, ~18.8 psig, Bias=54V, 96 hrs	0/252
uHAST	JESD22-A118	Ta=130C, RH=85%, ~18.8 psig, 96 hrs	0/240
PC	JESD22-A113	MSL __1__ @ __260C__ °C	
RSH	JESD22- B106	per AEC - Q101	0/90
NOTE: AEC-1pager is attached.			
<i>To view attachments:</i>			
1. Download pdf copy of the PCN to your computer			
2. Open the downloaded pdf copy of the PCN			
3. Click on the paper clip icon available on the menu provided in the left/bottom portion of the screen to reveal the Attachment field			
4. Then click on the attached file/			
Electrical Characteristics Summary:			
Electrical characteristics are not impacted.			



List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Current Part Number	New Part Number	Qualification Vehicle
NCV8405ADTRKG	NCV8405DTCRKG	NCV8406BDTRKG
NCV8405BDTRKG	NCV8405DTDRKG	NCV8406BDTRKG
NCV8406ADTRKG	NCV8406DTCRKG	NCV8406BDTRKG
NCV8406BDTRKG	NCV8406DTDRKG	NCV8406BDTRKG

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



変更件名:	ロジノフウェー工場における HD+B テクノロジーのウェーハーを 6 インチから 8 インチに変更	
初回出荷予定日:	09 Oct 2021	
現在の材料の最終注文日:	07 Jul 2021 既存品の最終注文日以降の注文は、この PCN に記載されている変更後品の注文とみなされます。この日付より後の既存品(変更前品)の注文は、相互契約により変更前品の在庫状況に応じて履行されます。	
現在の材料の最終出荷日:	08 Oct 2021 既存品(変更前品)の最終出荷日は、変更前品の製造および在庫の状況によって変更されることがあります。	
製品カテゴリ:	アクティブなコンポーネント - 集積回路	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Aaron.Zierenberg@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	サンプルの注文または < PCN.samples@onsemi.com > を注文するには、お近くの ON Semiconductor 営業所にお問い合わせください。 サンプルのリクエストは、この変更通知の公開後 45 日以内に提出してください。 サンプルの納品時期は、リクエスト日、サンプル数量、特別なお客様の梱包/ラベルの要件に従います。	
サンプル提供開始可能日:	07 Oct 2020	
PPAP 提供開始日:	05 Nov 2020	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または < Youngchul.Lee@onsemi.com > にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。 FPCN は、変更実施の 12 か月前、またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前に発行されることがあります。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 45 日以内に書面による問い合わせが行われたい限り、この変更希望およびその条件が受諾されたものとみなします。お問い合わせは、 PCN.Support@onsemi.com をお願いします。	
変更カテゴリ:	変更種別	
プロセス-ウェーハー製造	新規ウェーハー径	
説明および目的:	ウェーハーサイズを 6 インチから 8 インチに変更します。この変更は生産能力の向上を目的としています。	
	変更前	変更後
製品マーキング変更	8405AG	8405CG
	8405BG	8405DG
	8406AG	8406CG
	8406BG	8406DG
変更の理由 / 動機:	生産能力向上	
適合性、形状、機能、信頼性、製品安全性、または製造可能性に関して見込まれる影響:	製品は同じ製品仕様に基づいて認定および検証されています。製品は認定試験に正常に合格しています。潜在的な影響が確認される可能性があります。オン・セミコンダクターが PCN に関して実施する検査により、関連するリスクは検証および排除されます。 予想される影響はありません。	



影響を受ける拠点:

オン・セミコンダクター拠点:

外部製造工場 / 下請業者拠点:

ON Semiconductor Roznov, Czech Republic

無し

部品の表示 / 変更の追跡可能性:

新しい品番 (OPN) ではマーキングが更新されています。

信頼性データの要約:

デバイス名: NCV8406BDTRKG

RMS: OSV (RRF#61238, 69600) and SBN (RRF#61239)

パッケージ: 1186 (DPAK3)

テスト	仕様	条件	結果
HTRB	MILSTD750-1, method M1038A	Tj=150C, Bias=54V, 1008 hrs	0/300
ELFR	JESD22-A108	Ta=150C, Bias=10V, 24 hrs	0/2400
TC	JESD22-A104	Ta= -__55__°C to +__150__°C	0/240
HAST	JESD22-A110	Ta=130C, RH=85%, ~18.8 psig, Bias=54V, 96 hrs	0/252
uHAST	JESD22-A118	Ta=130C, RH=85%, ~18.8 psig, 96 hrs	0/240
PC	JESD22-A113	MSL __1__ @ __260C__ °C	
RSH	JESD22- B106	per AEC - Q101	0/90

添付文書を見るには:

1. ご使用のコンピューターに PDF 版の PCN をダウンロードします。
2. ダウンロードした PDF 版の PCN を開きます。
3. 添付欄を見るには、画面左 / 下部分のメニュー上にあるクリップアイコンをクリックしてください。
4. 添付ファイルをクリックします

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 標準の部品番号(既製品)のみが部品一覧に記載されます。本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メールのお客様の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

現在の部品番号	新部品番号	認定試験用ピークル
NCV8405ADTRKG	NCV8405DTCRKG	NCV8406BDTRKG
NCV8405BDTRKG	NCV8405DTRDKG	NCV8406BDTRKG
NCV8406ADTRKG	NCV8406DTCRKG	NCV8406BDTRKG
NCV8406BDTRKG	NCV8406DTRDKG	NCV8406BDTRKG